

Vacuum Bonding Machine

真空貼り合わせ装置

Model : VAP-250

装着概要 Product Outline

Siウェーハやサファイア基板など、さまざまなウェーハ（薄基板）をセラミックやSUSなどの支持基板にワックス装着させるための装置です。VAP-250はウェーハの反りをコントロールし、真空環境下で高精度に接着、極薄ウェーハの加工といった高精度加工を、効率的に行うことを可能にしました。

The VAP-250 mounts various wafers (thin substrates), such as Si wafers and sapphire substrates, to ceramic, SUS or other support substrates using wax. The VAP-250 controls the bow of wafers, adheres wafers at high precision in a vacuum environment, and processes super thin wafers. It is designed to efficiently perform these advanced operations.

特長 Features

1 ワックス層の厚みを極限までコントロール、高精度極薄ウェーハ製作を可能にしました。

Controlling the thickness of the wax layer to the limit, high precision super thin wafers can be manufactured.

2 試料加圧に空気圧力(ダイヤフラム方式)を採用、均一加圧を実現しました。

By employing air pressure to pressurize samples, uniform pressurization can be achieved.

3 真空環境下で貼り付ける事で広範囲な貼り付けムラや接着力不足をキッチリ解消します。

By bonding in a vacuum environment, nonuniform bonding and insufficient adhesive strength is resolved completely.



仕様 Specification

対象	Object		
支持基板径	Support substrate diameter	最大φ250mm対応	Maximum φ250mm Correspondence
加圧方法	Pressurizing Method	エア一加圧 (ダイヤフラム方式)	Air pressurizing (diamond Fullum method)
真空方法	Vacuum Method	バキュームポンプ	Vacuum pump
ホットプレート設定 温度範囲	Range of preset temperature of hot plate	常温～200℃ (任意設定)	Normal temperature～200℃ (Arbitrary setting)
加熱機構	Heating mechanism	ヒーター	Heater
冷却機構	Cooling mechanism	水冷式	Water-cooled
機械寸法 (フルオプション)	Machine dimensions (full option)	630W×400D×500H	630W×400D×500H

テクノライズ株式会社

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台 1-2-20 フロンティアビル5階
TEL.045-949-5008 FAX.045-949-6008

Techno Rise Corp.

5F Frontier Bldg. 1-2-20 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-0041, JAPAN
TEL : +81-45-949-5008 FAX : +81-45-949-6008

<http://www.technorise.ne.jp>